

# イオンミリング装置 ArBlade 5000

Ion Milling System ArBlade 5000

## 次世代のイオンミリング装置、 ArBlade 5000デビュー!



The most advanced ion milling system "ArBlade 5000" has been launched.

### 特 長 Feature

- 断面ミリングレート 1 mm/h<sup>\*1</sup>到達!
- 断面ミリング幅を最大8 mmまで拡張可能!
- ハイブリッドミリング(断面ミリング<sup>\*2</sup>、フラットミリング<sup>\*3</sup>)により  
多様なアプリケーションに対応

Cross-section milling rate : 1 mm/h!

Cross-section widths up to 8 mm!

New generation Hybrid instrument : Cross-section milling and Flat milling

### 主な仕様

共 通	
使用ガス	Ar(アルゴン)ガス
加速電圧	0~8 kV
断面ミリング	
最大ミリングレート(材料Si)	1 mm/hr <sup>*1</sup> 以上
最大試料サイズ	20(W) × 12(D) × 7(H) mm
イオンビーム間欠照射機能	標準装備
ワイドエリア断面ミリング機能	最大ミリング幅 : 8 mm
フラットミリング	
加工範囲	φ32 mm
最大試料サイズ	φ50 X 25 (H) mm
イオンビーム間欠照射機能	標準装備



※1 : マスクエッジからSiを100 μm突出させて1時間加工した際の最大の深さ

※2 : 切断や機械研磨では困難な柔らかい材料や複合材料の断面作製

※3 : 機械研磨試料の最終仕上げや試料表面の清浄化

※1 : This rate is the maximum depth processed for 1 hour when Si is protruded 100 μm from the mask edge. And for 1 hour processing.

※2 : Used to produce wider, undistorted cross sections without applying mechanical stress to the sample

※3 : Used for removing surface layer artifacts and final polish after traditional mechanical polish techniques